

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-020

# 深南电路股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本 339,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼		深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼
电话	0755-86095188		0755-86095188
电子信箱	stock@scc.com.cn		stock@scc.com.cn

### 2、报告期主要业务或产品简介

近年来，全球电子信息产业面临深刻变革，以5G通信技术、云计算、大数据、人工智能、新能源汽车和自动驾驶为代表的产业蓬勃发展，促使相关行业格局不断调整，电子产业呈现出结构性增长。印制电路板作为电子产品的关键互连件，其行业发展与宏观经济形势、下游市场需求等具有较强的相关性。报告期内，深南电路积极布局5G通信、数据中心等领域，把握行业发展机会，顺应时代发展及市场需求，实现了较好较快发展。

#### （一）主要业务与产品、经营模式以及行业地位

公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。公司成立于1984年，经过三十余年的深耕与发展，公司已成为中国印制电路板行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联制造的先进企业。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心；同时，作为中国电子电路行业协会（CPCA）的理事长单位及标准委员会会长单位，公司还主导、参与了多项行业标准的制定。根据Prismark2019年第四季度报告，深南电路

已迈入全球印制电路板行业前十厂商行列。

1、印制电路板产品

公司专业从事中高端印制电路板的设计、研发及制造，产品应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并持续深耕航空航天、工控医疗等领域。公司当前重点开拓的领域包括：

(1) 通信领域。公司自上世纪90年代进入通信PCB领域，至今已有二十余年经验技术积累。公司生产的通信印制电路板主要应用于无线网、传输网、核心网、固网宽带等企业级应用场景。2019年是中国5G建设与商用元年，伴随国家5G通信网络建设加快，公司积极配合客户开发通信设备端PCB产品，加快对高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化PCB产品的开发。

(2) 数据中心领域（含服务器）。随着各行业数字化、物联网和人工智能等应用逐渐落地，服务器需求呈现高速增长趋势，公司将持续加强对相关产品的开发，为市场突破做好技术准备。

经过多年的积累，公司在背板、高速多层板、高频微波板等各种中高端PCB加工工艺方面拥有了领先的综合技术能力，牢牢树立了PCB技术的行业领先地位。同时，公司持续加强专业化、自动化工厂布局，并积极推进智能制造。2019年上半年，公司南通数通一期工厂快速爬坡，当前产能爬坡已基本结束，产能利用率处于较高水平；南通数通二期工厂建设进展顺利，预计将于2020年一季度末投产。

公司PCB产品重点应用领域

应用领域	主要设备	相关PCB产品	特征描述	
通信	无线网	通信基站	背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板	金属基、大尺寸、高多层、高频材料及混压
	传输网	OTN传输设备、微波传输设备	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	核心网	路由器、交换机	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	固网宽带	OLT、ONU等光纤到户设备		多层板、刚挠结合
数据中心	交换机、服务器/存储设备	背板、高速多层板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合	
航空航天	航电、机电系统	高速多层板	高可靠性、多层板、刚挠结合	
工控医疗	工控、医疗系统		高可靠性、多层板、刚挠结合	
消费电子	电池保护、光学摄像、无线耳机等	软硬结合板、HDI	高密度、轻薄、立体组装、高可靠性	
汽车电子	毫米波雷达、激光雷达、摄像头、新能源汽车	高频微波板、刚挠结合板、厚铜板	高频材料及混压、高可靠性、HDI、刚挠结合、多层板、厚铜	

2、封装基板产品

封装基板是芯片封装不可或缺的一部分，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB母板之间提供电气连接。公司生产的封装基板产品主要分为五类，分别为存储芯片封装基板、微机电系统封装基板、射频模块封装基板、处理器芯片封装基板和高速通信封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务/存储等。

公司目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，并成为日月光、安靠科技、长电科技等全球领先封测厂商的长期合作伙伴，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。例如，公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中，全球市场占有率超过30%。射频模组封装基板大量应用于3G、4G手机射频模块封装；应用于嵌入式存储芯片的高端存储芯片封装基板已大规模量产；在处理器芯片封装基板方面，倒装封装（FC-CSP）基板已具备量产能力。

公司IPO募投项目的无锡基板工厂于2019年6月顺利连线试产，国际、国内存储类关键客户开发进度符合预期。

3、电子装联产品

电子装联系指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在

PCB上，实现电子与电气的互联，并通过功能及可靠性测试，形成模块、整机或系统，属于PCB制造业务下游环节。公司电子装联产品按照产品形态可分为PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、医疗电子、汽车电子、航空航天等领域，同时也加快布局工控、能源与设计等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力。

凭借专业的设计能力、扎实的技术实力、稳定可靠的质量口碑以及快速的客户响应，公司电子装联业务已与华为、通用电气等全球领先企业建立起长期战略合作关系。公司坚持深耕大客户策略，电子装联业务多年来始终保持稳定发展。为持续提高效率，公司同步推进自动化建设、智能立体仓库等项目。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	10,524,196,882.92	7,602,141,701.41	38.44%	5,686,939,441.08
归属于上市公司股东的净利润	1,232,775,470.34	697,252,358.02	76.80%	448,082,267.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,151,701,243.26	647,335,618.09	77.91%	381,526,217.32
经营活动产生的现金流量净额	1,262,866,434.48	879,133,564.83	43.65%	966,105,970.73
基本每股收益（元/股）	3.66	2.08	75.96%	1.33
稀释每股收益（元/股）	3.65	2.08	75.48%	1.33
加权平均净资产收益率	29.11%	20.38%	8.73%	25.61%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	12,219,367,752.05	8,525,409,856.54	43.33%	7,443,389,852.03
归属于上市公司股东的净资产	5,000,803,881.38	3,722,440,662.83	34.34%	3,167,779,894.93

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,162,870,945.88	2,628,671,122.56	2,866,510,014.59	2,866,144,799.89
归属于上市公司股东的净利润	186,768,322.15	284,274,432.54	396,329,109.99	365,403,605.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,483,039.19	266,792,708.50	385,730,156.32	326,695,339.25
经营活动产生的现金流量净额	61,157,302.82	409,527,353.02	373,771,190.55	418,410,588.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中航国际控股股份有限公司	国有法人	69.05%	234,334,764	234,334,764			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.69%	9,115,378	0			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.44%	4,903,078	0			
全国社保基金四零六组合	其他	1.01%	3,438,828	0			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,944,658	0			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	其他	0.46%	1,547,561	0			
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.45%	1,513,607	0			
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	其他	0.35%	1,188,303	0			
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	1,067,972	0			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.31%	1,038,319	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

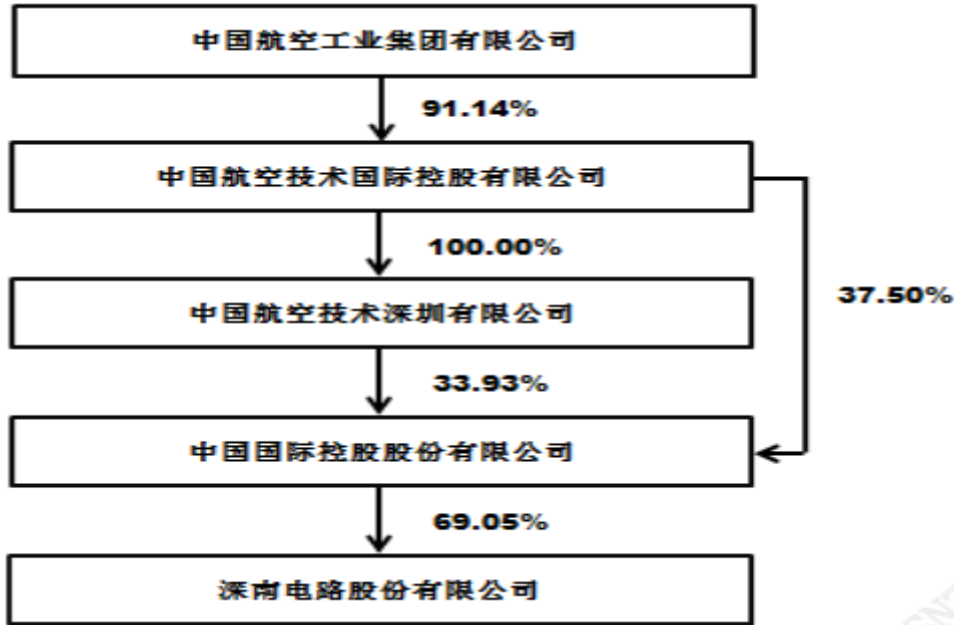
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，全球宏观环境形势受经贸摩擦等因素影响，经济发展的不确定性增加，加之环保监管日益趋严，PCB行业竞争压力持续加大，为PCB企业发展带来新的挑战。但以5G通信技术、云计算等为代表的产业蓬勃发展，也为公司带来了新的增长机会。

报告期内，公司持续落实“3-In-One”战略，积极应对内外部挑战。产品应用以通信设备为核心，不断加快新领域市场开发与突破，在存储、数据中心、新能源汽车和智能驾驶等领域取得一定突破。公司积极进行组织架构优化，激发组织活力，提高运营效率。在宏观经济高度不确定环境下，各项业务均保持快速的突破与发展。报告期内，公司实现营业总收入105.24亿元，同比增长38.44%；归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比增长76.80%。

(一) 印制电路板业务快速增长，盈利能力稳步提升

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入77.26亿元，同比增长43.63%，占公司营业总收入的73.41%；毛利率27.98%，同比去年提升4.94个百分点。

报告期内，通信、数据中心等公司下游主要应用领域需求持续提升，相关业务收入实现稳定增长。其中，5G通信PCB产品由小批量阶段逐步进入批量阶段，5G产品占比有所提升，4G通信PCB产品需求量维持相对稳定；数据中心业务客户拓展较为顺利，符合预期。

伴随公司南通数通一期工厂在报告期内逐步达产，且深圳、无锡等生产基地已有工厂持续实施技术改造项目，释放部分新增产能，公司印制电路板业务产出持续攀升。其中，南通深南全年实现营收12.40亿元，同比增长399.82%；南通数通二期工厂作为可转债募投项目建设进展顺利，预计将于2020年一季度末连线生产。同时，公司通过深化开展智能化改造和成本管控，持续提升现有工厂生产效率，在产出提升且费用平稳增长的情况下，盈利能力同比有所提升。

报告期内，公司印制电路板业务各项工作稳步开展并达成既定目标，质量、交付等表现优异，获得战略客户高度认可，如连续七年蝉联华为“金牌核心供应商”、连续八年获评中兴包括“全球最佳合作伙伴”在内的多个奖项，并荣获诺基亚2019“数字转型钻石奖”。

## （二）封装基板业务收入持续增长，无锡工厂产能爬坡有序进行

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入11.64亿元，同比增长22.94%，占公司营业总收入的11.06%；毛利率26.25%。

报告期内，公司声学类微机电系统封装基板产品（MEMS-MIC，即硅麦克风）技术和产量上继续保持领先优势，订单保持稳定增长；指纹类、射频模块类、存储类等封装基板产品订单情况良好，产品结构持续改善，为业务增长提供充足动力。公司IPO募投项目建设的无锡基板工厂于2019年6月连线试生产，目前仍处于产能爬坡阶段；该工厂主要面向存储类封装基板产品，客户开发进度符合预期。

凭借品质稳定、准时交付、工程服务等各方面的优异表现，报告期内，公司封装基板业务荣获安靠科技“最佳指纹供应商”、日月光“年度优秀供应商”等多个客户奖项。

## （三）电子装联业务强化运营能力，获得客户认可

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入12.11亿元，同比增长30.68%，占公司营业总收入的11.51%；毛利率19.51%，同比去年提升1.19个百分点。

报告期内，公司电子装联业务聚焦于通信、医疗、汽车、航电四大主要领域，持续深耕与开发大客户。其中，收入增长主要来自通信、医疗等领域的产品需求拉动。通过精益管理、自动化建设、供应链整合等多项举措并施，电子装联业务的产出效率持续提升，项目管理和内部运营能力不断改善，并荣获华为“制造质量奖-优秀工厂奖”、GE医疗“年度供应商大奖”、大唐“年度优秀供应商”等多个客户奖项。

## （四）加强研发投入占据行业技术前沿高地，产学研创新成果显著

报告期内，公司研发投入5.37亿元，同比增长54.77%，占公司营业总收入比例5.10%，主要投向下一代通信印制电路板、存储封装基板，主要面向高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化等重点领域。

2019年，公司自主研发的“高密度三维互连电子产品用PCB解决方案”入编2019年电子信息行业自主创新成果推广目录（原“盘古奖”）；《一种超薄无芯封装基板的加工方法和结构》获得第二十一届中国专利奖（优秀奖）；“4G手机射频模块封装用基板”、“大容量固态存储刚挠印制电路板”、“医疗超声探头用超薄铜柔性印制电路板”2019年被认定为广东省高新技术产品。此外，深南电路科学技术协会积极推动各项创新工作开展和工程师文化建设，全力支持公司科技工作实现新突破。

截止报告期末，公司已获授权专利455项，其中发明专利357项、国际PCT专利22项，专利授权数量位居行业前列。

## （五）持续推进管理创新变革，提高组织活力与效率

报告期内，公司积极进行流程与IT化建设、管理数字化升级，致力于打造流程型组织，持续提升信息化水平。通过不断优化人才“选育用留”机制，公司加速人才梯队建设，推动管理干部年轻化，积极引进优秀人才，匹配公司快速发展步伐。根据战略需求，公司灵活调整组织架构，强化对质量与流程、自动化建设、风险控制等方面的能力。

## （六）持续完善风控体系，不断加强风险管理

报告期内，外部宏观环境波动加剧，不确定性持续增加，公司高度关注外部环境变化与内部风险控制体系建设，促使各业务、各部门、子公司在其职责范围内建立并完善风险评估体系，根据各项业务的不同特点进行风险识别和评估，并制定匹配业务的风险管理策略、风险防范措施及解决方案，加强识别、评估和应对重大风险的能力，提升公司整体风险防御能力。同时，公司重点关注业务连续性相关风险，并正式启动业务连续性管理工作，通过邀请外部专家对公司高层及核心团队进行系统培训、内部管理诊断，积极开展相关实践探索，输出相关保障制度等方式加强业务连续性风险的管控。

**(七) 顺利发行可转换公司债券，支撑关键项目建设**

为适应下游技术发展、满足客户需求，公司在南通投资建设数通二期工厂，用以满足5G网络大规模建设推进后通信设备、数据中心领域的市场需求。

为支撑项目建设，经中国证监会“证监许可[2019]2554号”文核准，公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15.20亿元，募集资金用于数通二期工厂项目投资建设及补充流动资金。经深交所“深证上[2020]22号”文同意，公司可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“深南转债”，债券代码“128088”。此次可转债发行有力支撑了公司关键项目建设资金需求，有效匹配公司战略需求，助力公司稳步长效发展。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
印制电路板	7,726,181,864.20	2,161,945,347.21	27.98%	43.63%	74.46%	4.94%
电子装联	1,211,052,161.07	236,277,710.34	19.51%	30.68%	39.14%	1.19%
封装基板	1,164,043,290.59	305,553,178.50	26.25%	22.94%	8.70%	-3.44%
其他产品	134,578,669.37	31,796,630.76	23.63%	38.33%	30.46%	-1.42%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

详见第十二节、五、33 重要会计政策和会计估计变更。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。